

エンジニアリングセラミックスの新たな潮流

【オーガナイザー】

鈴木 達	吉田 克己	楠瀬 尚史	須山 章子	周 游	山田 鈴弥
物質・材料研究機構	東京工業大学	香川大学	(株)東芝	産業技術総合研究所	デンカ(株)

【セッション概要】エンジニアリングセラミックスは「安心・安全」な社会を実現するためのキーマテリアルとして注目されている。さらに、その機械特性を向上させるための微構造制御やプロセス手法は、機能性材料の長寿命化や信頼性、機能安定性向上への適用も期待される。本セッションでは、構造材料だけでなく機能性材料における機械特性や信頼性、機能安定性に関しても広く講演を募集し、この分野の今後の研究開発及び実用展開について議論する。

【セッションキーワード・トピックス】

構造材料、微構造制御、熱的、機械的特性、耐食性・耐酸化性、複合材料

【招待・依頼講演者】

岡村 光恭(NGS アドバンスファイバー株式会社)
佐藤 光彦(東京工科大学)

【発表形式】口頭発表・ポスター発表を募集。但し、申込件数により、発表形式の変更をお願いする場合があります。

【協賛・協力(予定)】[協賛]日本学術振興会先進セラミック材料第124委員会, 日本機械学会, 日本金属学会, 粉体工学会, 粉体粉末冶金協会
[協力]エンジニアリングセラミックス部会

【連絡先】

suzuki.tohru@nims.go.jp(物材機構, 鈴木達)
k-yoshida@nr.titech.ac.jp(東工大, 吉田克己)